

インバータ生産に最適な超音波接合システム Optimized bonding system for inverter production

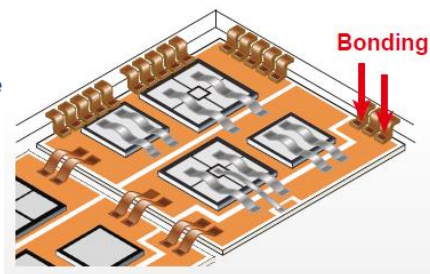


ヘッド荷重	荷重 50~1000N
ヘッド種類	超音波ヘッド
超音波周波数	周波数：19kHz(3000W)、30kHz(1250W)
ヘッド制御	荷重、超音波のデジタル制御
接合モニタリング	プロファイル参照ソフト標準搭載
レシピ	接合条件：デジタル設定
ユーティリティ	空圧源：0.5MPa ドライクリーンエア 電源：三相 200V30A
ユニットサイズ	W2128 × D1580 × H1838mm（本体部）
ユニット重量	1500kg

アプリケーション Application

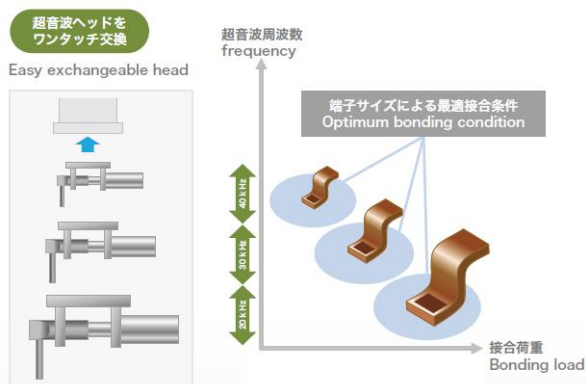
高温化するインバータなどの電極接続に最適
Suitable for electrical connection corresponding to high Temperature trend of inverter etc.

適用例
Inverter package



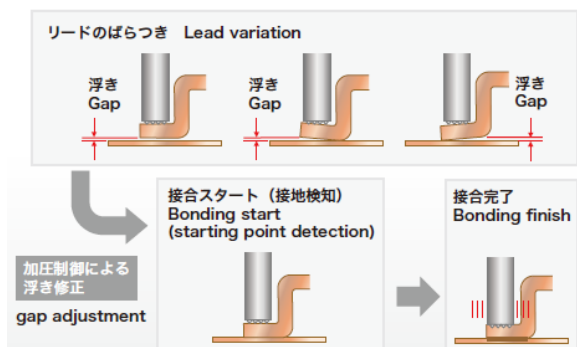
フレキシブル生産 Flexible production

多様な端子に最適な接合条件を1台の装置でカバー
Provide optimized bonding condition in one machine.



端子浮きに強い Stable production

接地荷重で浮きを押えて接合スタート
Hold down lead and start bonding



カラー画像処理 Color image recognition

カラー画像処理により端子とホーンを精度よく位置合わせ
Stable alignment with color recognition

